

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观 <input checked="" type="checkbox"/>其他（线上会议）</p>
<p>参与单位名称</p>	<p>富国基金、汇添富基金、广发基金、嘉实基金、鹏华基金、景顺长城基金、大成基金、上投摩根基金、招商基金、人保资产基金、国寿安保基金、安信基金、建信基金、东吴基金、长信基金、兴银基金、德邦基金、华宝基金、西部利得基金、明亚基金、富安达基金、摩根华鑫基金、民生加银基金、扬子江基金、深圳纽富斯投资、中金资管、中信建投资管、财通资管、长江资管、兴银理财、长城财富、华夏久盈资管、上海趣时资管、太保资产、生命人寿保险、国寿资产、太平养老保险、百年保险、珠江投资、银河金汇证券资产、太平资产、运存资本、Rays Capital、摩汇投资、凯石基金、易米基金、前海联合基金、九泰基金、上海运舟基金、上海格传基金、上海歌汝基金、和谐汇一基金、杭州弈宸基金、大朴投资、中再资产、知几资产、圆石投资、域秀投资、星石投资、贤盛投资、望正资产、冲积资产、睿亿资产、江苏瑞华投控、理成资产、凯丰投资、旌安投资、金昌资本、季胜投资、环懿投资、深圳红筹投资、杭银理财、国华兴益资管、东方马拉松投资、成泉资本、巴沃投资、赤钥投资、乾明投资、中意资产、圣为投资、上海劲邦投资、华美投资、上海博鸿投资、北京志开投资、招商证券、英大证券、安信证券、东方证券、海通证券、广发证券、方正证券、天风证券、浙商证券</p>
<p>时间</p>	<p>2023年1月5日 9:00-10:00, 13:30-14:30 2023年1月6日 15:30-17:00 2023年1月10日 15:00-16:00 2023年1月12日 9:30-11:30</p>
<p>地点</p>	<p>公司会议室、线上会议</p>

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>副总经理兼董事会秘书：高健 证券事务代表：陈国兵</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>一、介绍公司的特点</p> <p>1、（硅基和碳化硅）功率半导体核心供应链自主可控。公司是国内少有的具备硅基和碳化硅功率半导体自主可控供应链的企业，在外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计各环节均有布局。核心供应链自主可控，是公司功率半导体业务的核心竞争力，也是公司区别于其他纯芯片设计公司的主要优势所在。</p> <p>2、伴随功率半导体核心供应链的陆续投产及持续扩产，公司将步入快速成长通道。未来五年，公司所布局的功率半导体业务各环节（外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计）都将持续迭代扩产，成为公司发展最重要的增长极。</p> <p>二、介绍公司各业务板块基本情况和近期经营进展</p> <p>2022年，面对复杂的疫情防控和国际环境，公司扎实开展各项经营管理工作，整体保持稳健发展态势，各业务板块情况如下：</p> <p>1、条码识别设备业务：2022年受疫情影响，公司条码业务在商超零售端市场销售有所下滑，但在工业制造端有显著增长。</p> <p>2、电子元器件分销业务：2022年持续深耕汽车电子等新能源行业客户，并稳步发展新能源动力和储能电池代理业务。</p> <p>3、功率半导体业务板块：控股的设计公司广微集成，受制于6英寸代工厂产能迁移（后续6英寸代工将集中在广芯微电子），广微集成2022年产能有所下滑；参股硅片企业晶睿电子保持持续扩产，业绩逐季增长，公司按持股比例并入晶睿电子净利润，2022年晶睿电子业绩增长将对公司业绩产生正向显著贡献；晶圆代工厂广芯微电子和超薄片背道代工厂芯微泰克均处于建设期，尚未形成收入，暂未开始折旧计提，2022年对公司整体业绩影响相对较小。</p> <p>4、公司于2022年12月以4,800万元转让所持晶睿电子的2.0870%股权，经初步测算，本次交易产生的投资收益预计约为3,700万元（所得税前）。</p> <p>三、对于未来各业务板块展望</p> <p>1、条码识别设备业务：伴随公司国内外渠道的扩展、新品迭代及在工业场景的不断渗透，条码识别设备业务有望保持相对稳健成长。</p> <p>2、电子元器件分销业务：保持快周转和正向经营净现金，电子元器件分销业务保</p>

持相对平稳发展。

3、功率半导体业务：未来五年，外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计都将持续迭代扩产，有望实现持续快速增长。

四、互动问答

问题 1：公司在碳化硅产业链上有哪些布局？产能规划如何？公司在碳化硅业务方面的竞争优势是什么？

答：公司在功率半导体硅基器件和碳化硅器件领域均是基于供应链自主可控的战略进行布局。目前公司在碳化硅产业链布局覆盖外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工、芯片设计等关键环节，具体如下：

- 1、晶睿电子：2023 年将开展碳化硅外延片业务，已有意向客户；
- 2、晶圆制造：2023 年广芯微电子将提供碳化硅器件晶圆代工服务；
- 3、超薄片背道加工：2023 年芯微泰克将提供碳化硅器件超薄片背道加工服务；
- 4、芯片设计：广微集成将于 2023 年量产碳化硅器件（在广芯微电子代工）；另，公司参股芯片设计企业已量产碳化硅二极管和碳化硅 MOSFET。

公司参股晶圆代工厂广芯微电子一期产能为 10 万片/月（6 英寸），初期产能将以硅基功率器件产能为主，并少量布局碳化硅功率器件产能。硅基功率器件和碳化硅功率器件晶圆加工的前道工序基本可以通用，后续扩展碳化硅功率器件产能，只需要可在现有厂区洁净车间增加配置高温离子注入、高温退火等设备即可，硅基和碳化硅器件产能可以根据后续订单情况动态调整。后续公司将基于自主可控供应链，并结合市场情况，逐步推出更多的碳化硅功率器件量产产品。

公司在碳化硅业务方面的核心优势，在于基于核心供应链全链条布局，而非在单一环节进行布局。一方面，有助于整个供应链的技术合作和产品开发；另一方面，核心供应链产能可以得到保障，且成本具有相对优势。

问题 2：目前国内功率半导体领域的格局如何，公司在功率半导体领域有什么核心竞争优势？

答：国内功率半导体领域的整体市场竞争仍处于相对早期阶段，寡头垄断格局尚未形成，对于国产功率半导体企业而言，目前是一个非常好的发展机遇期。我国作为全球最大的功率半导体需求端市场，产业规模超千亿元，且随着新能源、储能、物联网等领域的快速发展，功率半导体产品的需求也在不断增长。一方面，目前国内功率

半导体企业的销售规模与国际龙头企业相比，差距较远，发展空间大；另一方面，国内中高端功率器件对进口依赖度较高，国产替代空间巨大。因此，随着国内功率半导体产业链的不断升级和发展，国内有望涌现出一批世界级的功率半导体企业。

公司在功率半导体领域的核心竞争优势在于核心供应链的自主可控。功率半导体器件是特色工艺，需要在设计、制造、原材料等方面进行特色化定制，以及产业链上下游密切配合，因此，在关键环节具备自主可控供应链，是成为优秀功率半导体企业的必由之路。公司致力于打造功率半导体领域 smart IDM 生态圈，近几年已先后完成了在功率半导体设计、外延片制造、晶圆制造、超薄片背道加工等关键环节的布局，未来公司将全力支持所投资功率半导体产业链企业建成投产并持续扩产，充分释放 smart IDM 生态圈的强大产业链协同效益，不断提升公司核心竞争力。

问题 3：公司在功率半导体领域后续是否有新的投资计划？

答：公司致力于在功率半导体领域打造的 smart IDM 生态圈已初步成形，目前完成了在功率半导体设计、原材料硅片、晶圆代工、超薄片背道代工等关键环节的布局，未来几年将全力支持所投资功率半导体产业链企业建成投产并持续扩产，充分释放 smart IDM 生态圈的强大产业链协同效益；同时，公司将持续关注特色功率半导体设计领域，对技术能力优秀的设计公司进行投资，并利用产业链进行赋能，帮助其做强做大，以不断壮大 smart IDM 生态圈。

问题 4：晶圆代工厂广芯微电子的建设进度以及下游客户情况如何？

答：广芯微电子项目目前的厂房建设及机电安装等工程已步入尾声，12 月下旬设备开始陆续进场进行安装调试，以及二次配管的准备工作；广芯微电子团队成员已有一百多人，核心团队成员配置完备，其中不少是在国内外大厂工作二三十年的高管和技术骨干。由于目前由于丽水市正处于新冠感染高峰期，项目现场施工受此影响工期有所延后，项目预计今年上半年完成通线量产工作。

广芯微电子致力于成为国内晶圆代工厂的典范，定位中高端功率器件的晶圆代工业务。中高端功率器件代工产能及超薄片背道代工产能均为国内稀缺资源，且广芯微电子的核心团队成员平均拥有二十年以上从业经验和丰富的业界资源，目前已有充足的客户储备。广芯微电子将优先为广微集成提供晶圆代工产能保障，此外，广芯微电子已经筛选并确定若干家技术能力优秀的功率器件设计公司作为一期产能代工客户，因此广芯微电子下游客户需求可充分覆盖一期产能。

	<p>问题 5：疫情对公司各业务的影响如何？</p> <p>答：条码业务方面：受疫情影响，2022 年公司在零售商超端销售有所下滑，海外市场因疫情及运输原因，销售也受到一定影响；随着疫情影响逐步消除，消费市场端的业务有望恢复，加上条码识读设备在工业和能源领域的快速增长，公司条码业务将保持稳健增长。</p> <p>功率半导体业务：丽水的晶圆代工厂广芯微电子及超薄片背道代工厂芯微泰克目前处于建设阶段，近期丽水也处于感染高峰期，现场施工受到一定影响，进度有所延后。公司与广芯微电子、芯微泰克，将密切和各施工单位保持沟通，在保障安全的前提下确保项目尽快建成和投产。</p> <p>问题 6：广微集成目前的主要产品有哪些，未来有哪些新品规划？</p> <p>答：广微集成目前主要产品为 MOS 场效应二极管（MFER）、分离栅低压场效应晶体管（SGT-MOSFET），MFER 产品应用领域包括光伏接线盒、工业电机电源、网络电源及手机快充等高端电源管理市场；SGT-MOSFET 产品目前主要应用于储能 BMS 电源输出和电路保护系统，未来也将拓展至新能源汽车电子领域。广微集成是国内功率半导体设计企业中较少可提供 45V-150V 全系列 MOS 场效应二极管产品的企业，且是国内少数在 12 英寸晶圆厂成功量产分离栅低压场效应晶体管的企业，公司新产品、新技术储备丰富，待今年晶圆代工厂广芯微电子投产后，将逐步推出包括 900-1500V 高压 MOS、IGBT、FRD、碳化硅器件等系列新品。</p> <p>问题 7：公司对条码业务未来几年的发展展望？</p> <p>答：条码业务作为公司现金奶牛业务，一直保持较高的毛利率，且每年的净利润基本可转化为正向经营净现金，并不断进行产品技术迭代。未来，公司条码业务将继续加大开拓工业及新能源领域市场，特别是 2022 年以来，随着工业物联网、数字化、智能化等高端制造业的发展，中高端条码识别产品需求在不断增长，公司条码识别设备在新能源汽车、储能电池等领域销售增长迅速；同时，公司也将根据市场需求不断推出新产品，并加大海外市场开拓力度。因此，预计未来几年，公司条码业务将保持稳定增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023-01-12